

BAT60B

肖特基二极管芯片(4 ")

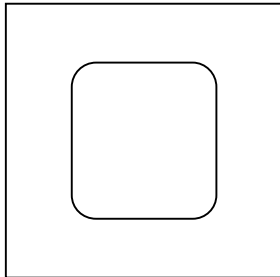
■用途:

高速开关应用
电路保护
电压箝位

■特征:

* 正向压降小
* 结电容小
*适用于片式封装
*有效图形数 9000 只

■芯片示意图



■芯片结构

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 芯片尺寸 | 810 μ m×810 μ m |
| 压焊区尺寸 | 580 μ m×580 μ m |
| 芯片厚度 | 200±20 μ m |
| 锯片槽宽度 | 80 μ m |
| 金属层 | 正面: Al 3.1±0.3μm 背面: Au 1.4±0.2μm |

■电特性(Ta=25℃)

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 最大 | 典型值 | 单位 |
|--------|----------------|---------------------------|----|------|------|-----|
| 正向压降 | V _F | I _F =1A | | 0.6 | 0.55 | V |
| 反向击穿电压 | V _R | I _R =1mA | 10 | | 15 | V |
| 反向漏电流 | I _R | V _R =5V | | 15 | | μ A |
| 结电容 | C _j | V _R =5V,f=1MHZ | | 30.0 | | PF |